

中微 VS 北方华创 VS 泛林半导体 VS 应用材料

半导体设备产业链深度梳理

从 2020 年下半年开始，半导体产能紧缺的问题就开始发酵，从手机电源管理芯片→汽车芯片→存储芯片，挨个开始涨价，德国整车厂甚至写联名信，向台积电要产能。

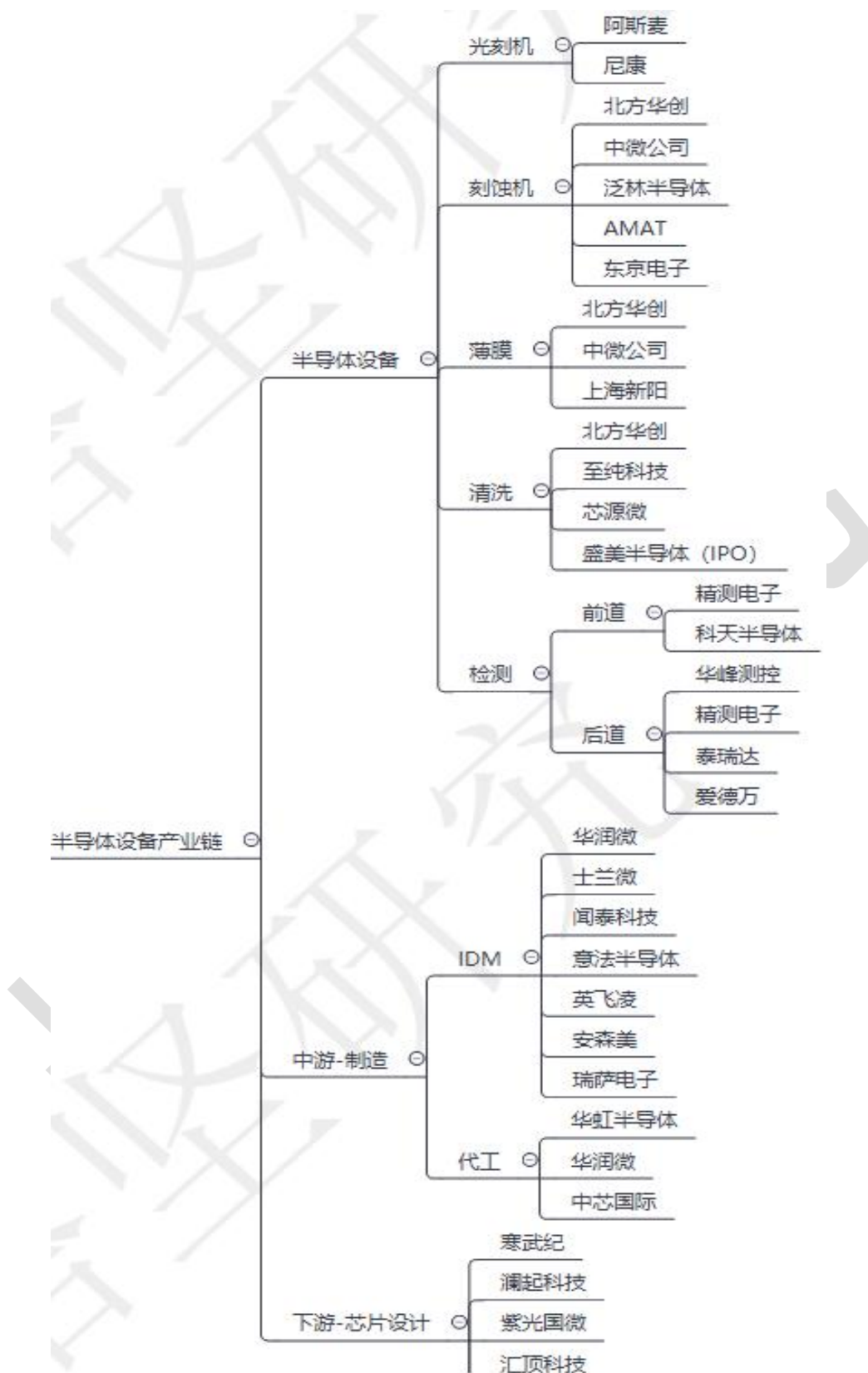
晶圆厂扩产能，核心就是要做设备采购。半导体设备行业，可分为六大主要设备，按投资额占比由大到小，分别为：光刻机（30%）、刻蚀机（20%）、镀膜设备（15%）、清洗设备（10%）、测量设备（10%）、离子注入设备（5%）。本文，重点研究刻蚀设备。

刻蚀设备所在的半导体产业链，上中下游分别为：

上游——为设备和原材料供应商。国内设备代表公司有，**刻蚀机**：中微公司、北方华创；**镀膜设备**：北方华创、芯微源；**清洗设备**：北方华创、盛美股份、至纯科技；**测量设备**：长川科技、精测电子、华峰测控；

中游——为晶圆制造厂。全球产能排名前五的**晶圆厂**依次是：三星电子、台积电、美光科技、SK 海力士、铠侠，其合计产能占全球晶圆厂总产能的 50%，是半导体设备的主要采购方；

下游——为半导体应用领域。主要分为：集成电路、光电子器件、分立器件、传感器等四大类终端应用，其中，集成电路为主要应用终端，占比为 84%，其次为光电子器件，占比 9%。



图：半导体产业链

来源：塔坚研究

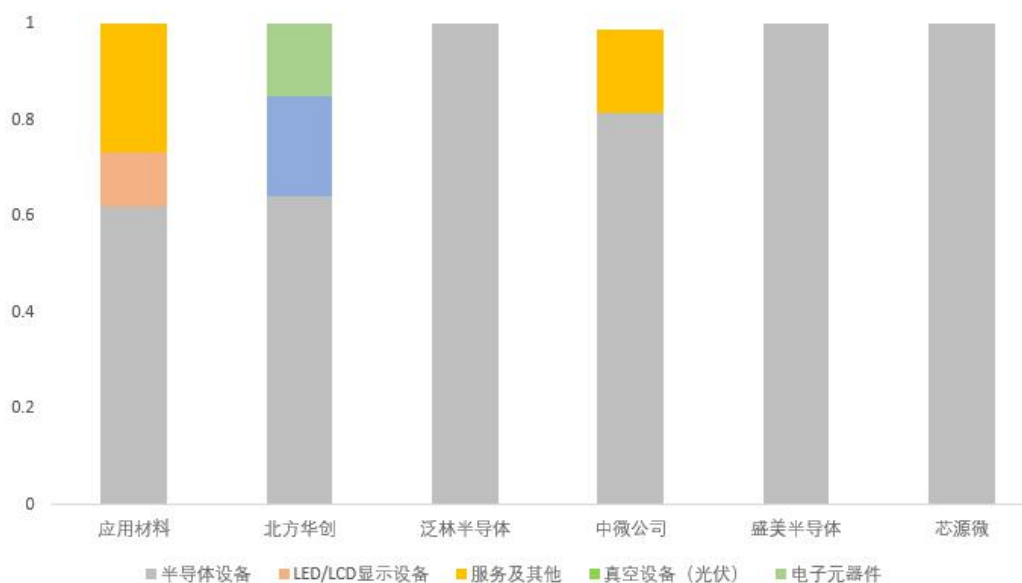
对于这条产业链，有几个值得我们深入思考的问题：

- 1) 半导体设备产业链，其长期增长驱动力是什么？短期受什么因子扰动？
- 2) 中微公司 VS 北方华创，它们的竞争力差异究竟在哪里？竞争力的核心指标，到底该看什么？

(壹)

本报告，我们选取应用材料 VS 北方华创 VS 泛林半导体 VS 中微公司 VS 盛美股份 VS 芯源微，作为刻蚀设备代表性公司进行对比。

从收入结构来看，五家公司均以半导体设备为主，但侧重点略有不同：



图：收入结构

来源：塔坚研究

单从收入规模维度：泛林半导体（1033.5 亿元人民币）> 应用材料（663.65 亿元人民币）> 北方华创（40.58 亿元）> 中微公司（19.47 亿元）> 盛美股份（7.56 亿元）> 芯源微（2.12 亿元）。其中：

北方华创 VS 中微公司——均以半导体设备为主，前者产品覆盖面广，后者专注 IC 刻蚀设备。

北方华创——2019 年收入 40.58 亿元，60%以上的收入来自泛半导体设备，覆盖半导体 IC、LED、光伏三大领域。其半导体设备产品众多，包括刻蚀机、PVD、CVD、ALD、氧化/扩散炉、清洗机、外延设备等。

中微公司——2019 年收入 19.47 亿元，81%收入来自半导体设备，其余为半导体设备配件。其以半导体 IC 刻蚀设备起家，由于单一半导体产品周期波动大，而后拓展 MOCVD 设备（用于 LED 外延片生长）。

应用材料 VS 泛林半导体——前者产品，基本覆盖晶圆制造过程中除光刻机外的所有设备；后者以刻蚀设备为主。

应用材料 (AMAT) ——2019 财年收入 146.08 亿美元, 以泛半导体设备为主 (包括: 芯片、光伏、LED), 共有四大事业部门: 半导体设备 (占比 62%)、面板显示设备 (11%)、服务 (26%)、其他 (1%)。

泛林半导体 (LRCX) ——2019 财年收入 96.54 亿美元, 100%来自半导体 IC 设备, 未披露产品收入结构, 根据其市占率, 我们倒推出其主营业务为刻蚀设备, 占营收比重在 50%以上, 其余为半导体清洗设备、薄膜沉积设备等。

芯源微 VS 盛美股份——两家刻蚀设备专用于先进封装 (后道)。

盛美股份——产品以半导体清洗设备为主 (占比 84%), 10.6%来自半导体电镀设备, 5.3%来自现金封装刻蚀设备 (封装用湿法刻蚀, 晶圆制造用干法刻蚀, 其中技术差异, 详见我们之前在科技版报告库中的“刻蚀设备”一篇, 此处不详述)。

芯源微——产品以光刻工序中的涂胶显影设备为主 (占比 64%), 12.26%来自封装用湿法刻蚀设备, 11%来自清洗机。

从半导体 IC 制造前道设备来看，应用材料、北方华创基本覆盖除光刻机之外的所有前道设备；泛林半导体、中微主攻刻蚀设备。盛美以清洗机为主，芯源微以涂胶设备为主，两家公司刻蚀设备主要用于后段封测。

接下来，我们从 2020 年 3 季报数据，分别对比一下四家公司的增长情况：

| | 营业收入 [报告期] 2020 三季 [报表类型] 合并报表 [单位] 亿元 | 营业收入 (同比增长率) [报告期] 2020 三季 [单位] % | 归母净利润 [报告期] 2020 三季 [报表类型] 合并报表 [单位] 亿元 | 归母净利润 (同比增长率) [报告期] 2020 三季 [单位] % | 销售毛利率 [报告期] 2020 三季 [单位] % | 销售净利率 [报告期] 2020 三季 [单位] % |
|-------|---|---|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 泛林半导体 | 471.45 | -0.54 | 101.08 | -5.73 | 45.89 | 21.44 |
| 应用材料 | 813.41 | 15.29 | 161.72 | 23.90 | 44.45 | 19.88 |
| 中微公司 | 14.76 | 20.83 | 2.77 | 105.26 | 34.48 | 18.85 |
| 北方华创 | 38.36 | 40.31 | 3.27 | 48.86 | 34.82 | 10.17 |

图：2020 年三季度数据（单位：亿元人民币、%），

来源：塔坚研究

从增速来看，北方华创 > 中微公司 > 应用材料 > 泛林半导体，盛美股份还未上市，无三季度数据。

泛林半导体——其收入负增长是由于统计的财务年份差异导致（2020 财年三季报的报告期为 2019/12/29-2020/03/29），2019 年为半导体周期低点，晶圆厂扩产需求较低。

单看 2021 财年 1 季报（报告期 2020/6/30-2021/9/30），其营业收入同比增长 46.7%，净利润同比增长 76.79%。其增长主要来自于中国晶圆厂设备订单大幅增加，中国订单占比从 27%提升至 37%，成为其设备收入的主要来源。

应用材料——截至 2020 年 7 月，营业收入约 813.41 亿元人民币，同比增长 15.29%，净利润 161.72 亿元人民币，同比增长 23.9%。其增长主要来自于中国、韩国晶圆厂的大规模扩产带来的设备采购需求提升，分地域来看，中国占其收入比重提升至 33%，为其主要收入来源。

中微公司——刻蚀设备为业绩增长主要贡献，LED 设备拉低增速。2020 年前三季度营业收入、净利润分别同比增长 20.83%、105.26%。其发布 2020 年业绩预告，预计 2020 年营业收入同比增长 16.8%，净利润同比增长同比增加 133.34%到 175.77%。

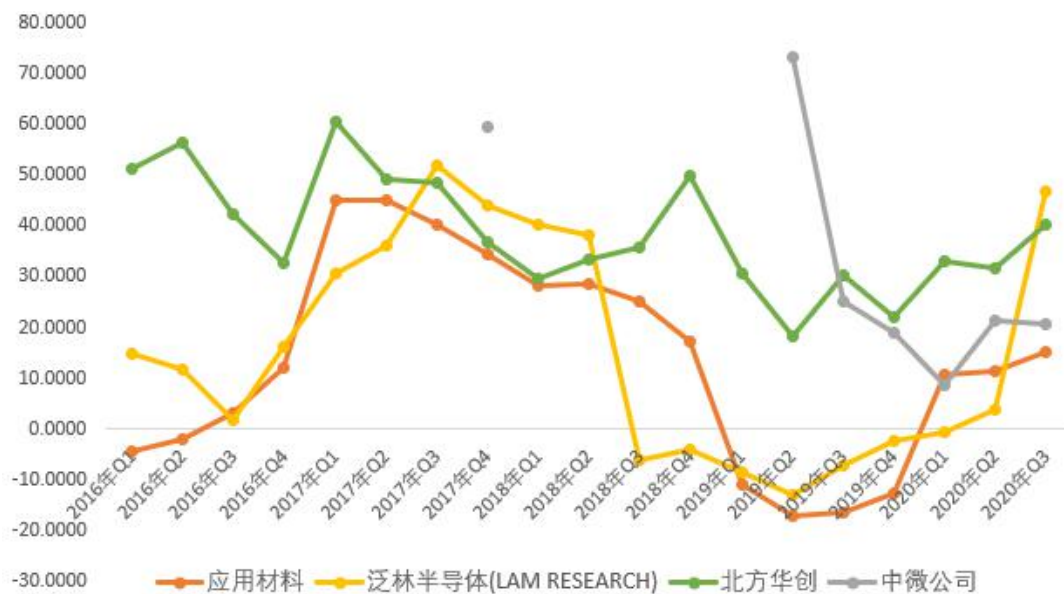
其中，刻蚀设备收入增长约 58.5%，但 MOCVD 设备收入下降约 38.5%，刻蚀设备与 MOCVD 设备占比从 2019 年的 48%/52% 变为 2020 年的 70%/30%。整体来看，半导体设备成长性更强。

北方华创——光伏及半导体行业的双重景气度拉动其业绩增长。

2020 年前三季度营业收入、净利润分别同比增长 40.31%、48.86%。3 季度毛利率下降，主要由于光伏设备占比增高。

分业务来看，光伏及锂电设备增速居首（75%以上），其次是半导体设备（28.77%），再次是电子元件（12.31%）。

由于泛林半导体报告期比其他公司早半年，我们将其季度增速前置调整 2 个季度，能够发现，几家设备公司的季度增速存在一定规律性，与半导体行业周期波动较为一致。



图：季度收入增速（单位：%）

来源：塔坚研究

(贰)

好，增长看完后，我们再来看回报对比：

从回报水平（ROIC）来看，泛林半导体 > 应用材料 > 盛美股份 > 中微公司 > 北方华创。海外龙头回报水平基本在国内两大设备公司的5-6倍。

| | | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
|------|---------------------|-------|-------|-------|
| ROA | 应用材料 | 23.11 | 26.50 | 19.06 |
| | 泛林半导体(LAM RESEARCH) | 15.82 | 26.41 | 20.95 |
| | 中微公司 | 4.31 | 5.38 | 4.45 |
| | 北方华创 | 3.16 | 4.39 | 4.34 |
| | 芯源微 | 8.31 | 8.53 | 4.47 |
| | 盛美股份 | 4.79 | 22.41 | 16.31 |
| ROIC | 应用材料 | 27.24 | 24.72 | 21.08 |
| | 泛林半导体(LAM RESEARCH) | 16.88 | 25.49 | 24.07 |
| | 中微公司 | 36.83 | 6.62 | 5.92 |
| | 北方华创 | 4.55 | 6.89 | 6.47 |
| | 芯源微 | 14.89 | 14.68 | 5.94 |
| | 盛美股份 | 13.30 | 66.20 | 24.57 |
| ROE | 应用材料 | 41.46 | 40.93 | 35.95 |
| | 泛林半导体(LAM RESEARCH) | 26.71 | 35.75 | 39.22 |
| | 中微公司 | | 7.63 | 6.43 |
| | 北方华创 | 3.87 | 6.82 | 6.57 |
| | 芯源微 | 15.47 | 14.76 | 6.01 |
| | 盛美股份 | 22.46 | 95.69 | 27.67 |

图：回报数据（单位：%）

来源：塔坚研究

回报的差异，来自两方面：1) 销售净利率；2) 总资产周转率。

销售净利率——北方华创的净利率为 9.17%，低于中微公司的 9.69%、芯源微的 13.73%、盛美股份的 17.83%、应用材料的 18.52%、阿斯麦的 21.93%、泛林半导体的 22.7%、科天半导体的 25.72%。

单看各家半导体芯片设备业务的毛利率，6家公司基本都在45%左右（半导体设备行业基本毛利率），导致综合净利率有差异，主要来自两方面：

1) 半导体设备公司，除了芯片设备外，普遍存在部分泛半导体设备拉低整体毛利率的情况，包括光伏、LED、面板设备等，毛利率基本在35%左右。涉及以上设备业务的中微公司、北方华创，毛利率会低于行业平均水平。

2) 收入体量较小，但研发其实是刚性的，导致研发费用率波动较高，如中微公司，研发费用率近年来持续提升，从5.8%上升至2020年第三季度的14%，海外半导体公司稳定在10%左右。

总资产周转率——北方华创的总资产周转率为0.34次，低于中微公司的0.47次、应用材料的0.79次、泛林半导体的0.79次。总资产周转率国内公司远低于海外同行，主要原因是存货周转率较低。

国内设备厂商会通过放宽设备使用验证期来吸引客户，导致其大量销售设备在客户验证阶段，这类机器作为存货占比较高，拉低了周转率。

但是北方华创与应用材料相比,二者净利率水平和净资产收益率差距较大,由于应用材料的总资产周转率几乎是北方华创的3倍,所以二者的净资产收益率也有较大差距。

| | | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
|--------|---------------------|-------|-------|-------|
| 净利率 | 应用材料 | 23.62 | 19.20 | 18.52 |
| | 泛林半导体(LAM RESEARCH) | 21.19 | 21.49 | 22.70 |
| | 中微公司 | 3.08 | 5.54 | 9.69 |
| | 北方华创 | 7.53 | 8.51 | 9.11 |
| | 芯源微 | 13.83 | 14.51 | 13.73 |
| | 盛美股份 | 4.28 | 16.82 | 17.83 |
| 总资产周转率 | 应用材料 | 0.85 | 0.93 | 0.79 |
| | 泛林半导体(LAM RESEARCH) | 0.66 | 0.90 | 0.79 |
| | 中微公司 | 0.58 | 0.56 | 0.47 |
| | 北方华创 | 0.30 | 0.37 | 0.34 |
| | 芯源微 | 0.60 | 0.59 | 0.33 |
| | 盛美股份 | 0.79 | 1.15 | 0.78 |
| 权益乘数 | 应用材料 | 2.05 | 2.30 | 2.44 |
| | 泛林半导体(LAM RESEARCH) | 1.92 | 1.85 | 2.19 |
| | 中微公司 | | 2.44 | 1.42 |
| | 北方华创 | 2.26 | 2.65 | 2.52 |
| | 芯源微 | 1.86 | 1.73 | 1.34 |
| | 盛美股份 | | 4.95 | 1.99 |

图：杜邦因素拆分（单位：%、次）

来源：塔坚研究

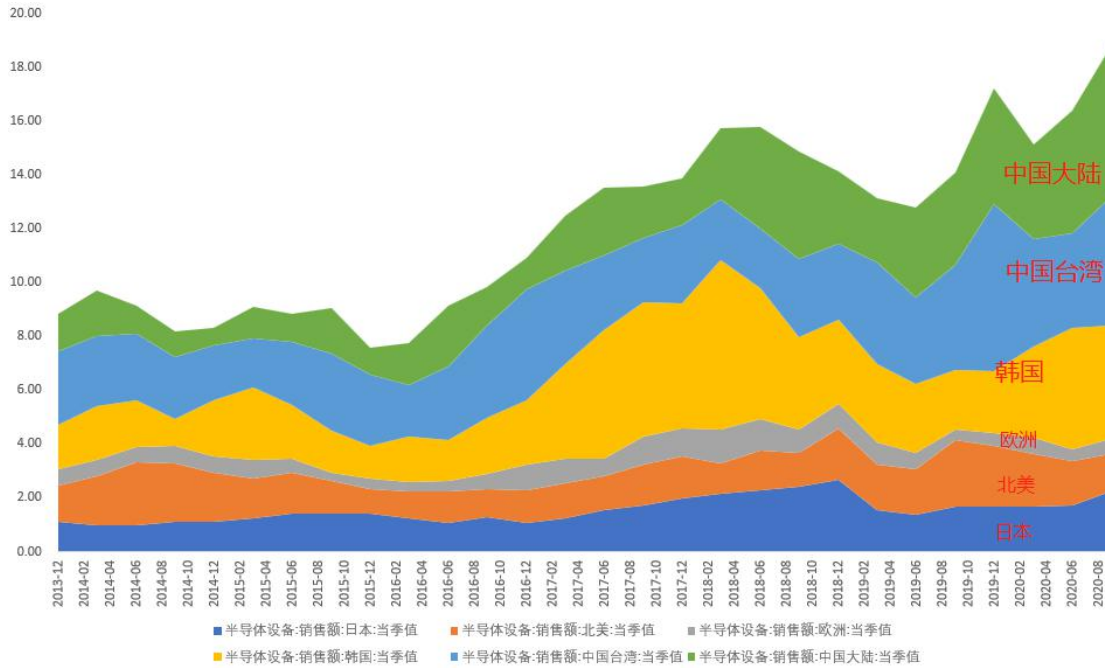
半导体设备行业，增长驱动力主要来自于下游产能的扩张。其公式可以表达为：

刻蚀设备市场规模=半导体设备市场规模*刻蚀设备占比；

核心因子一：全球半导体设备的市场规模。

2018年-2020年Q3，全球半导体设备市场规模分别为572.2亿美元、503.1亿美元，同比增速为-5.4%、26%。中国大陆、中国台湾、韩国地区成为全球半导体设备采购主力，分别占比27%、24%、24%，合计占比达到75%，并且这一趋势还在加速。

从前三季度设备采购同比增速来看，中国、韩国同比增速达到50%、57%，而北美、欧洲增速分别为-16%、-7%。从上述趋势来看，未来东亚地区，是半导体设备的主要市场。

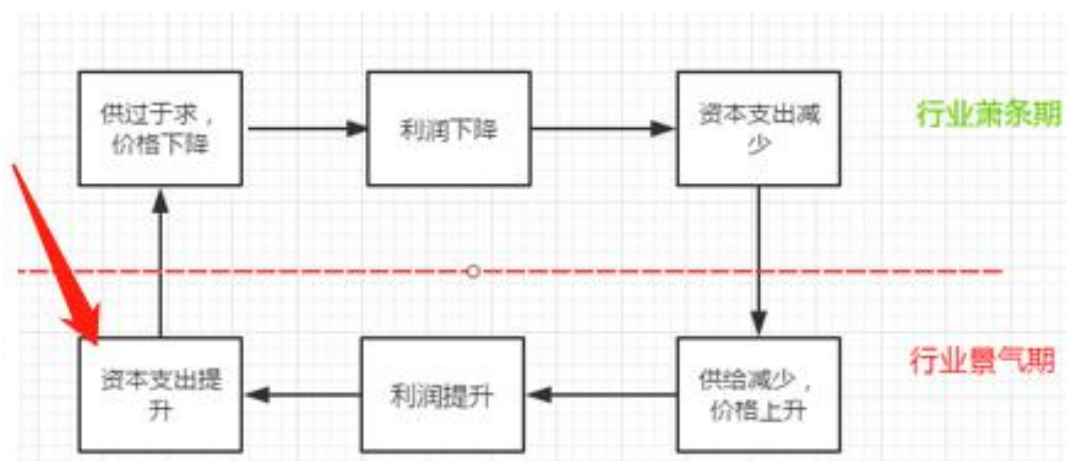


半导体设备的销售规模，其核心驱动因素是晶圆加工厂的资本开支，而晶圆加工厂的资本开支规划，有两个因素决定：

- 1) 管理层对半导体行业周期景气度的判断；
- 2) 产业转移带来的机会。

首先，半导体周期景气度，目前到了什么位置？

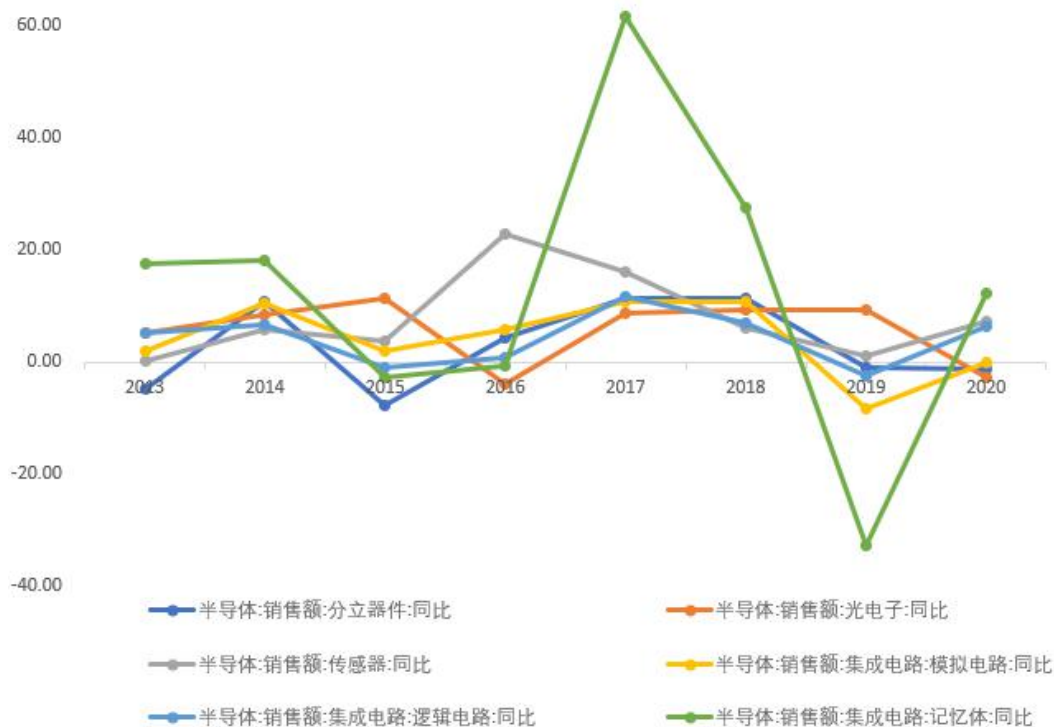
半导体当前出现紧缺严重，主要是供给与需求的不匹配导致。其传导路径如下：供给减少、价格上升→利润率提升→加大资本开支→设备采购额提升：



图：半导体周期传导图

来源：塔坚研究

需求端——回顾 2020 年，整个半导体需求端（除 LED 外）开始回暖，全球半导体销量同比增长 6.2%，需求增速排名前三的依次是，存储芯片同比增长 12.2%、传感器同比 7.4%、逻辑电路 6.5%。



图：半导体销售额同比增速

来源：WIND

半导体集成电路下游需求主要有四大类：消费电子、服务器、个人电脑、汽车及工业。需求端景气度如下：

1) 智能手机，中等景气。2020 年全球共销售 13.4 亿部，同比下降 2.28%，5G 手机销量 3.26 亿部，渗透率 24%。注意，虽然智能手机销量在下降，5G 手机的硅含量相比 4G 增加 35%，若按此计算，智能手机对半导体需求为正向拉动。

2) 服务器及 PC，高景气。卫生事件导致在家办公及宅家游戏风潮，拉动笔记本电脑及服务器需求增长，分别同比增加 15%、3.8%。

3) 汽车，高景气。全球共销售汽车 7680 万辆，同比下降 15%，电动车销量 324 万辆，同比增长 50%。与智能手机情况相近，虽然汽车销量在下降，但新能源车芯片用量是燃油车的 3 倍，电动化和智能化带来的芯片用来大幅提升。

供给端——2019 年全球半导体产业资本支出为 946 亿美元，同比下降 11.7%。2019 年全球晶圆厂扩产并不积极，导致 2020 年半导体行业整体产能出现下滑。

结合供需来看，问题来了——需求高景气，供给却没有恢复，因此，半导体景气度上升有迹可循。那么，未来两年，管理层资本支出预算是否会增加？

我们重点来看全球晶圆厂产能排名前 8（合计占全球总产能 60%以上）的厂商：

1) 中国台积电。2021 年资本支出预计 250 亿美元至 280 亿美元，同比增加 38%-54%，其中 80% 用于 3nm、5nm、7nm 先进制程，10%将投向特殊制程工艺，10%将投向先进封装等领域。

2) 三星电子。2021 年计划资本支出增加 20%，金额约 296 亿美元，其中 68%用来投资存储芯片，32%用来逻辑芯片代工。预计到 2021 年 NAND 增加月产能达 7.3-8.5 万片，DRAM 增加 3 万片产能。

3) 美光/海力士。美光 2021 年资本支出预计 82 亿美元，同比增加 10%至 90 亿美元，预计到 2021 年 DRAM 同比增长 15%~19%，NAND 同比增长 30%。海力士由于利润下滑，预计下修资本支出，2021 年投资主要用来技术升级。

4) 铠侠（原东芝存储器）。存储器 IC 供应商以前是，计划扩大生产规模，重点在 3D NAND 闪存。

5) 英特尔/台联电/格芯（Global Foundry）。联电格芯均上修资本支出，重点在先进制程扩产，英特尔资本支出与 2020 年相近，用于突破先进制程，其 3nm 预计转单台积电。

结合以上信息，可以推断，半导体行业景气度已经位于较高水平，管理层基本都采取了积极的扩产态度。从前五大厂商来看，未来 1 年扩产重点在两方面：1) 先进制程；2) 3D NAND。

我们预计，2020 年-2021 年全球半导体设备投资额分别同比增长 23%、12%，预计从 2022 年开始，随着供应爬坡，景气度开始下降。

| 单位：亿美元 | 2019 | 2020E | 2021E | 2022E | 2023E | 2024E |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 全球半导体设备投资额 | 597.6 | 735.0 | 820.3 | 820.3 | 918.8 | 1029.0 |
| YoY | -8% | 23% | 12% | 0% | 12% | 12% |

图：全球半导体设备投资额

来源：塔坚研究

具体来看国内半导体产业, 由于国内晶圆厂的产能和资本支出规划主要受到政策、产业转移的影响。我们分开测算。

根据广发证券, 国内晶圆厂近三年建设带来的设备需求预计约为 180 亿美元、264 亿美元、353 亿美元, 增速分别为 33.7%、47.0%、33.6%。

短期内, 晶圆厂扩张仍以存储芯片、低端制程逻辑芯片为主。在建项目中, 产能扩张幅度有大至下依次是: 3D NAND > DRAM > 逻辑芯片。

其中, 长江存储 (以 3D NAND 为主)、合肥长鑫 (3D NAND 为主)、中芯国际 (低端制程为主)、紫光存储 (3D NAND 为主), 士兰微、华润微、中车时代等主要以功率半导体、传统制程为主。

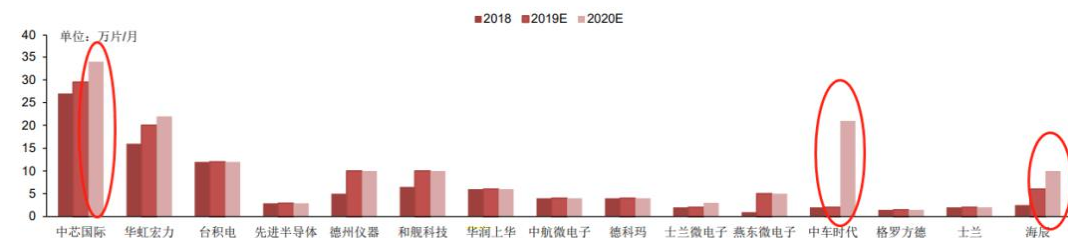
图 52：国内已建、已规划 12 英寸晶圆产能格局



图：国内已建已规划 12 英寸产能格局

来源：浙商证券

图 51：国内已建、已规划 8 英寸晶圆产能格局



图：国内已建已规划 8 英寸产能格局

来源：浙商证券

综上，未来两年的设备支出，海外重点看先进制程、存储带来的设备投入，国内重点存储芯片厂扩张带来的设备投入。

| 单位：亿美元 | 2019 | 2020E | 2021E | 2022E | 2023E | 2024E |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 中国半导体设备投资额 | 134.5 | 181.6 | 200.1 | 200.1 | 230.1 | 264.6 |
| yoy | | 35% | 10% | 0% | 15% | 15% |

图：国内半导体市场规模测算

来源：塔坚研究

看完半导体设备整体投资额的增速后，我们再细分来看刻蚀设备。

(肆)

核心因子二：刻蚀设备占设备投资额比重。

一般情况下，新晶圆投建或老厂房的 CAPEX，绝大部分是设备采购，约占总投入的 70-80%。其中，光刻 (20%) > 刻蚀 (20%) > 薄膜沉积 (15%) > 前道检测 (10%) > 清洗 (7%)。

根据上文结论，未来 1-2 年晶圆厂 CAPEX 重点在：

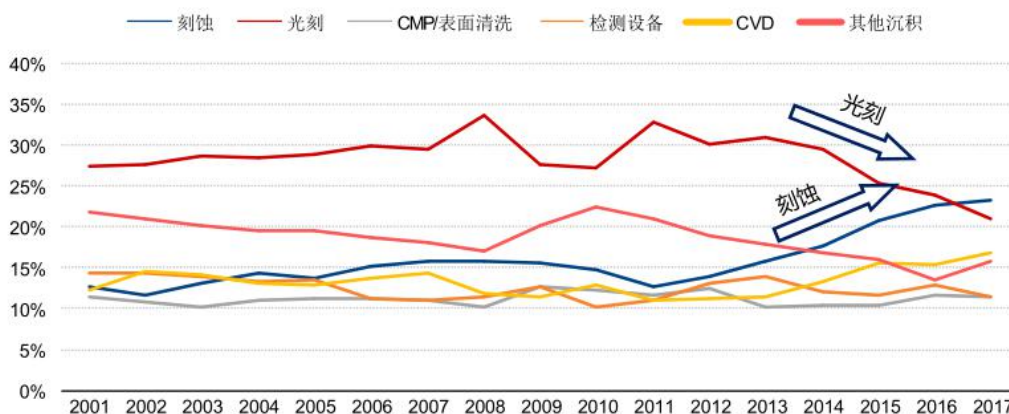
- 1) 先进制程；
- 2) 存储。

我们一一来分析。

先进制程方面，在 EUV 光刻机市场化前，由于 DUV 光刻机的光源精度不足，想要继续提升制程，需要采用“多次曝光”技术，导致刻蚀设备、薄膜沉积设备使用量大幅增加。

从具体数据来看，刻蚀设备在晶圆产线的价值占比，从 2011 年大约 13% 上升到 2017 年的 24% 左右，而光刻机的价值占比从大约 33% 下滑到 21% 左右，薄膜沉积（CVD）设备从 11% 提升至 16% 左右。

图 17：2001-2017 年各类设备在晶圆厂中的价值占比



图：各类设备占晶圆厂价值占比

来源：华创证券

从半导体全行业维度来看，随着阿斯麦的 EUV 光刻机突破现有的技术瓶颈后，对刻蚀设备的要求会有所下降，因此，理论上需求也会有所下降，但需要注意的是，国产刻蚀设备的逻辑相反。

国内方面，受制于宏观情况，大陆晶圆厂较难采购 EUV 光刻机，因此，逻辑芯片领域，对刻蚀设备的需求量仍较大。

国内刻蚀设备占比的提升的驱动，主要来自于存储制造，国内存储扩产主要为 NAND，其中 3D NAND 随着层数翻倍，导致刻蚀设备占比存在向上的可能性。

在闪存制造工艺中，晶圆厂通过增加叠堆层数，来提升提高性能。从 2D NAND → 3D NAND，再从 32 层 3D NAND → 64 层 → 128 层过渡过程中，每增加一层，都需要增加刻蚀步骤。

根据东京电子，2D NAND 刻蚀设备占设备成本比重为 16%，而到了 3D NAND，刻蚀设备占比达到 49%。

全球第二大 NAND 制造商 KIOXIA (铠侠) 指出：“3D NAND is etch driven”，即 3D NAND 受刻蚀驱动。

图 13：2D NAND 中刻蚀设备占比

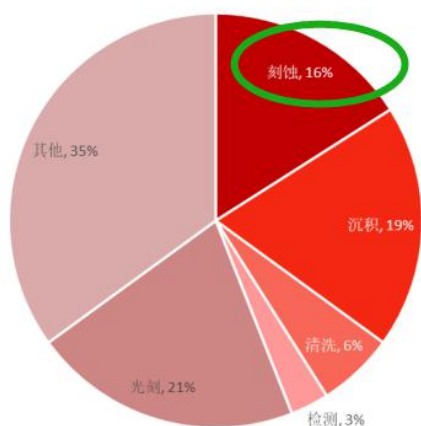
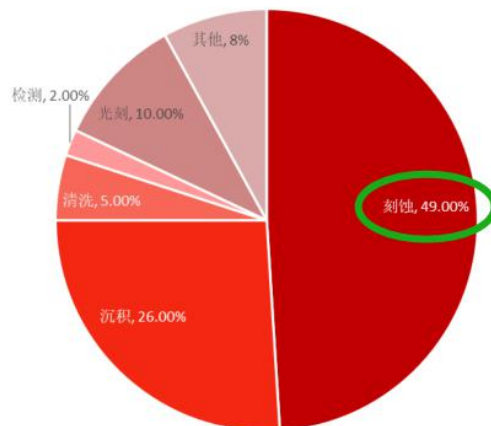


图 14：3D NAND 中刻蚀设备占比（占比明显提升）



来源：东京电子、国融证券

综上，全球刻蚀设备市场规模，未来五年从 119 亿美元增长至 211 亿美元，五年复合增速 12%，其中 3D NAND 刻蚀设备复合增速 18%，DRAM 刻蚀设备复合增速 12%，逻辑芯片刻蚀设备 2%。

| | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|------------------|--------|-------|--------|--------|--------|----------|
| 全球半导体设备市场规模 | 597.6 | 735 | 820.3 | 820.3 | 918.81 | 1056.632 |
| yoy | | 23% | 12% | 0% | 12% | 15% |
| 刻蚀设备占比 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 全球刻蚀设备市场规模 | 119.52 | 147 | 164.06 | 164.06 | 183.76 | 211.33 |
| 其中：3D NAND占比 | 43% | 45% | 48% | 50% | 53% | 55% |
| 3D NAND 刻蚀设备市场规模 | 51.39 | 66.74 | 78.42 | 82.36 | 96.66 | 116.23 |
| 其中：DRAM占比 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| DRAM刻蚀设备市场规模 | 29.88 | 36.75 | 41.02 | 41.02 | 45.94 | 52.83 |
| 其中：逻辑占比 | 32% | 30% | 27% | 25% | 22% | 20% |
| 逻辑刻蚀设备市场规模 | 38.25 | 43.51 | 44.62 | 40.69 | 41.16 | 42.27 |

图：刻蚀设备市场规模

来源：塔坚研究

国内刻蚀设备市场规模，未来五年从 25 亿美元增长至 66 亿美元，五年复合增速 21%，其中存储刻蚀设备复合增速 25%，逻辑设备增速 19%。

| 单位：亿美元 | 2019 | 2020E | 2021E | 2022E | 2023E | 2024E |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 中国半导体设备投资额 | 134.5 | 181.6 | 200.1 | 200.1 | 230.1 | 264.6 |
| yoy | | 35% | 10% | 0% | 15% | 15% |
| 其中：刻蚀设备占比 | 19% | 20% | 21% | 23% | 24% | 25% |
| 中国刻蚀设备市场规模 | 25.6 | 36.7 | 42.8 | 45.2 | 54.8 | 66.1 |
| 其中：3D NAND 和DRAM 占比 | 37% | 38% | 40% | 41% | 43% | 44% |
| 存储刻蚀设备市场规模 | 9.5 | 14.1 | 17.0 | 18.6 | 23.3 | 29.1 |
| 其中：逻辑刻蚀设备占比 | 60% | 59% | 58% | 58% | 57% | 56% |
| 逻辑刻蚀设备市场规模 | 15.3 | 21.7 | 25.0 | 26.0 | 31.1 | 37.0 |

图：国内刻蚀设备市场规模

来源：塔坚研究

研究至此，我们可以发现，因此，国内刻蚀设备，远期总体增速能够达到 21%，其中，存储客户的增速更快，因此，在刻蚀设备中，得存储客户者得天下。

(伍)

短期高频指标，我们分别采用 DXI 指数、NAND 现货价格、半导体设备出货量、下游景气度等多个维度进行追踪。

.....
以上，仅为本报告部分内容,仅供试读。

如需获取本报告全文及其他更多内容，请订阅科技版报告库。

一分耕耘一分收获，只有厚积薄发的硬核分析，才能在关键时刻洞见未来。

· 订阅方法 ·

长按下方二维码，一键订阅



扫码了解核心产品-科技版报告库

了解更多，可咨询工作人员：bgysyxm2018

【版权与免责声明】 1) 版权声明：版权所有，违者必究，未经许可不得以任何形式翻版、拷贝、复制、传播。2) 尊重原创声明：如报告内容有引用但未标注来源，请随时联系我们，我们会删除、更正相关内容。3) 内容声明：我们只负责财务分析、产业研究，内容不支持任何形式决策依据，也不支撑任何形式投资建议。本文是基于公众公司属性，根据其法定义务内向公众公开披露的财报、审计、公告等信息整理，不为未来变化做背书，未来发生任何变化均与本文无关。我们力求信息准确，但不保证其完整性、准确性、及时性。所有内容仅服务于行业研究、学术讨论需求，如为股市相关人士，请务必取消对本号的关注。4) 阅读权限声明：我们仅在公众平台仅呈现部分报告内容，标题内容格式均自主决定，如有异议，请取消对本号的关注。5) 主题声明：鉴于工作量巨大，仅覆盖部分重点行业及案例，不保证您需要的行业都能覆盖，也不接受私人咨询和问答，请谅解。6) 平台声明：所有内容以微信平台为唯一出口，不为任何其他平台内容负责，对仿冒、侵权平台，我们保留法律追诉权力。

【数据支持】 部分数据，由以下机构提供支持，特此鸣谢——国内市场：Wind 数据、东方财富 Choice 数据、理杏仁；海外市场：Capital IQ、Bloomberg、路透，排名不分先后。想做海内外研究，以上几家必不可少。如大家对以上数据终端有意向，欢迎和我们联系，我们可代为联络相关负责人。